

TRF3302、1165MHz から 1630MHz、マルチバンド、GPS と GNSS、低ノイズアンプ

1 特長

- GNSS L1 (GPS)、E1、B1 の各帯域：
 - ノイズ指数 (NF): 0.85dB
 - 入力反射損失 (S11): -11.7dB
 - 出力反射損失 (S22): -15.3dB
 - 2 要素入力一致
- マルチバンド GPS/GNSS L1、L2、L5 のサポート：
 - ノイズ指数 (NF): 1.2dB
 - 入力反射損失 (S11): -12dB
 - 出力反射損失 (S22): -12.3dB
 - 4 要素入力一致
- パワーゲイン (G_p): 16.9dB
- 入力 IP3 (V_{CC} = 2.5V):
 - 帯域内 = -5.4dBm
 - 帯域外 = -4.8dBm
- 入力 P1dB: -10.2dBm (V_{CC} = 2.5V)
- 統合 50Ω 出力一致
- 消費電流: 4.6mA (10nA シャットダウン)
- 柔軟な電源電圧: 1.8V ~ 3.3V
- 動作時接合部温度: -40°C ~ +125°C
- 自動光学検査 (AOI) 互換パッケージ: ウェットプル フランク付き WSON-FCRLF-6
- 車載 AEC-Q100 のバリエーションとして利用可能: TRF3302-Q1

2 アプリケーション

- GNSS レシーバ LNA
- 全地球測位レシーバ
- アセットトラッカー (資産追跡機能)
- スマート追跡機能
- テレマティクス制御ユニット (TCU)
- インテリジェントアンテナモジュール
- 車載用緊急通報 (eCall)
- 通行料電子徴収システム (ETC)
- ナビゲーションおよび全地球測位システム

3 説明

TRF3302 は、GNSS レシーバアプリケーション用に設計された、高ゲイン、低ノイズアンプ (LNA) です。デバイスの電力ゲインは 16.9dB で、高感度 GNSS レシーバ対応の 0.85dB という超低ノイズ指数を実現しています。入力換算 P1dB は -10.2dBm で IP3

は -5.4dBm であるため、携帯電話帯域からの妨害信号が存在する場合でもレシーバの感度を維持するのに役立ちます。

TRF3302 の広帯域設計は、GPS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavIC/IRNSS、GLONASS などの、幅広い GNSS 衛星配置をサポートしています。このデバイスはイリジウム衛星システムの L バンドにも対応しています。2 素子 (コンデンサとインダクタ) の入力一致により、L1 (GPS)、E1 (Galileo)、B1 (BeiDou) 帯域での低ノイズと優れた反射損失性能を実現します。インダクタの値は調整可能で、より低い GPS 帯域 L2 から L5、Galileo E6 から E5a、BeiDou B3 から B2a、QZSS L6、NavIC L5、GLONASS 帯域 G2 から G3 に対応する必要があるアプリケーション向けに、パフォーマンスの低下を最小限に抑えながら約 150MHz の帯域幅を実現します。4 素子の外部入力マッチング回路と TRF3302 の広帯域出力を組み合わせることで、すべての主要 GNSS 帯域で、約 1.2dB の NF、S11 と S22 が -10dB より優れた値の性能を実現します。

TRF3302 1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、電源設計と熱感度設計の制約が厳しい設計に対応するため、消費電流をわずか 4.6mA に抑えています。このデバイスにはデジタルロジック互換のイネーブルピンが搭載され、さらに消費電力を削減できます。TRF3302 は -40°C ~ +125°C の接合部動作温度が定格となっています。

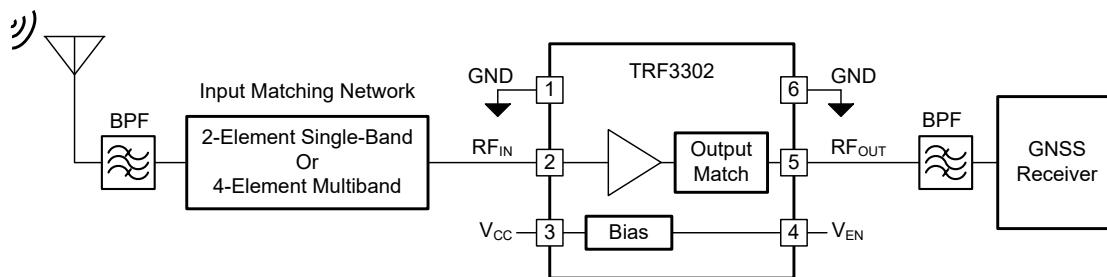
パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
TRF3302	ウェットプルフラック付き VBL (WSON-FCRLF、6)	1.3mm × 1mm

(1) 詳細については、[セクション 10](#) を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。





標準的な GNSS レシーバシステム

目次

1 特長.....	1	6.3 機能説明.....	17
2 アプリケーション.....	1	6.4 デバイスの機能モード.....	17
3 説明.....	1	7 アプリケーションと実装.....	18
4 ピン構成および機能.....	3	7.1 アプリケーション情報.....	18
5 仕様.....	4	7.2 代表的なアプリケーション.....	18
5.1 絶対最大定格.....	4	7.3 電源に関する推奨事項.....	20
5.2 ESD 定格.....	4	7.4 レイアウト.....	20
5.3 推奨動作条件.....	4	8 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	21
5.4 熱に関する情報.....	4	8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	21
5.5 電気的特性 - GPS L1 帯域.....	5	8.2 サポート・リソース.....	21
5.6 電気的特性 - GPS L5 および L2 帯域.....	6	8.3 商標.....	21
5.7 標準特性 - GPS L1 帯域.....	7	8.4 静電気放電に関する注意事項.....	21
5.8 標準特性 - GPS L5 および L2 帯域.....	12	8.5 用語集.....	21
6 詳細説明.....	16	9 改訂履歴.....	21
6.1 概要.....	16	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	21
6.2 機能ブロック図.....	16		

4 ピン構成および機能

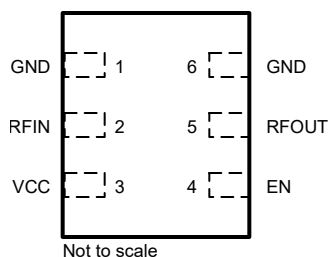


図 4-1. VBL パッケージ、6 ピン WSON-FCRLF (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ	説明
番号	名称		
1	GND	グラウンド	RF および DC グラウンド。PCB グラウンド プレーンに接続します。
2	RFIN	入力	RF 入力。オプションの外部 DC ブロッキングコンデンサ。内部で 50Ω に一致。
3	VCC	電源	電源。
4	EN	入力	グラウンドを基準とする、デバイスイネーブル信号。電圧を印加する必要があります。 ロジック 1 = イネーブル。 ロジック 0 = パワーダウン。
5	RFOUT	出力	RF 出力。DC ブロッキングコンデンサを内蔵し、内部で 50Ω に一致。
6	GND	グラウンド	RF および DC グラウンド。PCB グラウンド プレーンに接続します。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V _{CC}	電源電圧 ⁽²⁾			3.45	V
RF _{IN} , RF _{OUT}	RF ピンの電圧 ⁽²⁾	V _{CC} ≤ 2.05V, RF なし	-1.4V	V _{CC} + 1.4V	V
		V _{CC} > 2.05V, RF なし	-1.4V	3.45V	
P _{IN}	入力 RF 電力			10	dBm
V _{EN}	イネーブルピン電圧 ⁽²⁾	V _{CC} ≤ 2.75V	-0.7V	V _{CC} + 0.7V	V
		V _{CC} > 2.75V	-0.7V	3.45V	
T _J	接合部温度		-40	150	°C
T _{stg}	保存温度		-55	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて言及しており、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) GND を基準とします。

5.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン ⁽¹⁾	±1750	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JS-002 に準拠、すべてのピン ⁽²⁾	±1500	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V _{CC}	電源電圧	1.75		3.3	V
T _J	接合部温度	-40		125	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TRF3302	単位
		VBL (WSON-FCRLF)	
		6 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	152.1	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	78.5	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	44.2	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	2.9	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	44.1	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

5.5 電気的特性 - GPS L1 帯域

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1575\text{MHz}$ (L1 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT 次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
RF 性能						
	動作周波数		1300	1575	1630	MHz
G _P	小信号パワーゲイン	$P_{IN} = -27\text{dBm}$	$V_{CC} = 1.8\text{V}$	12.3	16.9	19.5
			$V_{CC} = 2.5\text{V}$	12.8	16.8	19.7
			$V_{CC} = 3.3\text{V}$	12.8	16.8	20.7
NF	ノイズ指数	$V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		0.85		dB
S ₁₁	入力リターンロス	$P_{IN} = -27\text{dBm}$ 、 $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		-11.7		dB
S ₂₂	出力リターンロス	$P_{IN} = -27\text{dBm}$ 、 $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		-15.3		dB
S ₁₂	逆アイソレーション	$P_{IN} = -27\text{dBm}$ 、 $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		-42.5		dB
IP1dB	入力 1dB の圧縮ポイント	ジャマーなし	$V_{CC} = 1.8\text{V}$		-13.2	dBm
			$V_{CC} = 2\text{V}$		-11.7	
			$V_{CC} = 2.5\text{V}$	-14.7	-10.2	
			$V_{CC} > 2.5\text{V}$		-10.2	
	入力 1dB の圧縮ポイント	$f_{JAM} = 850\text{MHz}$ 、 $P_{JAM} = -20\text{dBm}$	$V_{CC} = 1.8\text{V}$		-14.4	dBm
			$V_{CC} = 2.5\text{V}$		-10.7	
	入力 1dB の圧縮ポイント	$f_{JAM} = 1850\text{MHz}$ 、 $P_{JAM} = -20\text{dBm}$	$V_{CC} = 1.8\text{V}$		-13.8	dBm
			$V_{CC} = 2.5\text{V}$		-10.8	
IIP3	帯域内入力の 3 次インターセプトポイント	$P_{IN} = -25\text{dBm}$ /トーン、 5MHz トーン間隔	$V_{CC} = 1.8\text{V}$		-5.5	dBm
			$V_{CC} = 2\text{V}$		-5.4	
IIP3 _{OOB}	帯域外入力の 3 次インターセプトポイント	$P_{IN} = -25\text{dBm}$ /トーン、帯域外の $f = 1575\text{MHz}$ 、 $f_1 = 1713\text{MHz}$ および $f_2 = 1851\text{MHz}$ 時	$V_{CC} = 1.8\text{V}$		-5.7	dBm
			$V_{CC} = 2\text{V}$		-5.2	
			$V_{CC} = 2.2\text{V}$		-4.8	
K	Rollett 安定度係数		1			
DC パラメータ						
V _{CC}	電源電圧		1.8		3.3	V
I _{CC}	アクティブ電源電流	$V_{CC} = 1.8\text{V}$ 、RF なし	3	4.6	5.9	mA
		$V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、RF なし	3.2	4.6	5.9	mA
		$V_{CC} = 3.3\text{V}$ 、RF なし	3.2	4.6	7	mA
	アクティブな消費電力	$V_{CC} = 1.8\text{V}$ 、RF なし		8.3	10.6	mW
		$V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、RF なし		11.5	14.8	
		$V_{CC} = 3.3\text{V}$ 、RF なし		15.2	23.1	
I _{SHDN}	シャットダウン時の電源電流	$V_{CC} = 1.8\text{V}$ 、RF なし		0.01	1	μA
		$V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、RF なし		0.01	1	
		$V_{CC} = 3.3\text{V}$ 、RF なし		0.05		
t _{ON}	ターンオン時間	90% P _O に対する 50% EN 制御		1.4		μs
t _{OFF}	ターンオフ時間	10% P _O に対する 50% EN 制御		0.4		μs
パワーダウ制御レベル						
V _{IH}	High レベル入力電圧	ロジック 1、 $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$	1.5			V
V _{IL}	Low レベル入力電圧	ロジック 0、 $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$			0.4	V

5.6 電気的特性 - GPS L5 および L2 帯域

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1176\text{MHz}$ (L5 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT 次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
RF 性能						
	動作周波数		1165	1176	1320	MHz
G_p	小信号パワーゲイン	$V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$, $P_{IN} = -27\text{dBm}$		16.5		dB
NF	ノイズ指数	$V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		0.8		dB
S_{11}	入力リターンロス	$P_{IN} = -27\text{dBm}$, $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		-12.9		dB
S_{22}	出力リターンロス	$P_{IN} = -27\text{dBm}$, $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		-9		dB
S_{12}	逆アイソレーション	$P_{IN} = -27\text{dBm}$, $V_{CC} = 1.8\text{V} \sim 3.3\text{V}$		-43.6		dB
IP1dB	入力 1dB の圧縮ポイント	ジャマーなし	$V_{CC} = 1.8\text{V}$	-13.4		dBm
			$V_{CC} = 2\text{V}$	-12		
			$V_{CC} = 2.5\text{V}$	-10.6		
IIP3	帯域内入力の 3 次インターセプトポイント	$P_{IN} = -25\text{dBm}$ /トーン、 5MHz トーン間隔	$V_{CC} = 1.8\text{V}$	-6.1		dBm
			$V_{CC} = 2\text{V}$	-6		
K	Rollett 安定度係数		1			

5.7 標準特性 – GPS L1 帯域

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1575\text{MHz}$ (L1 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

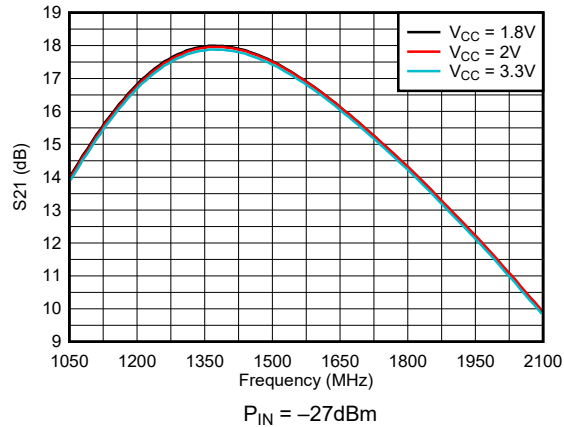


図 5-1. V_{CC} 範囲におけるパワーゲイン (S_{21})

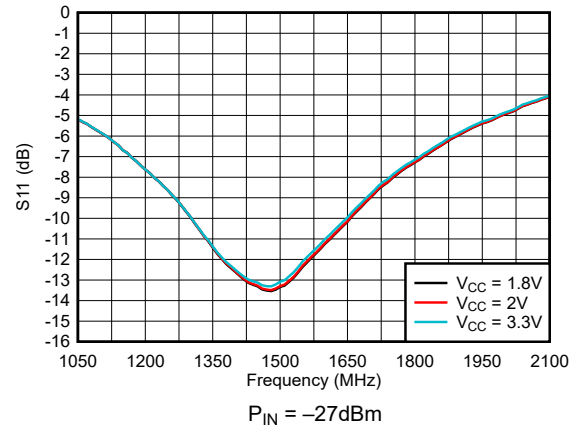


図 5-2. V_{CC} 範囲における入力反射損失 (S_{11})

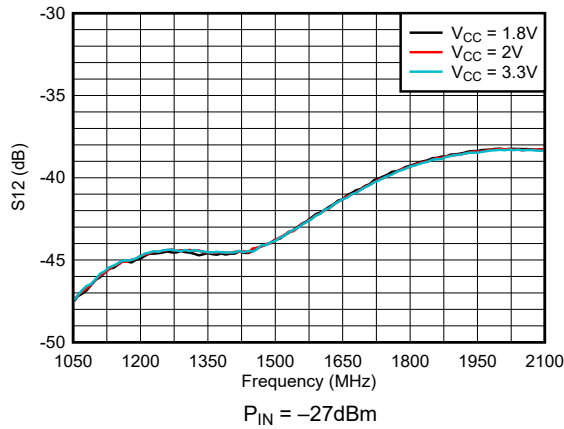


図 5-3. V_{CC} 範囲に置ける逆絶縁 (S_{12})

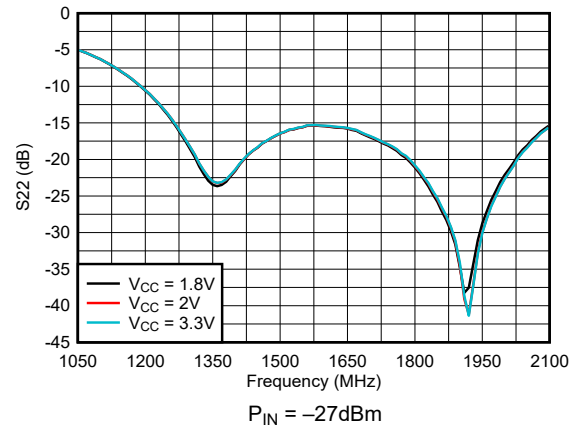


図 5-4. V_{CC} 範囲における出力反射損失 (S_{22})

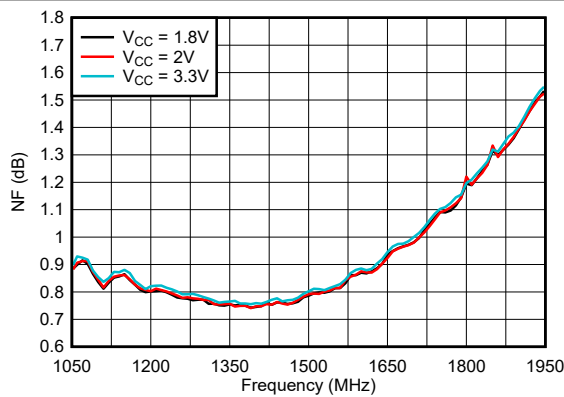


図 5-5. V_{CC} 全体での NF

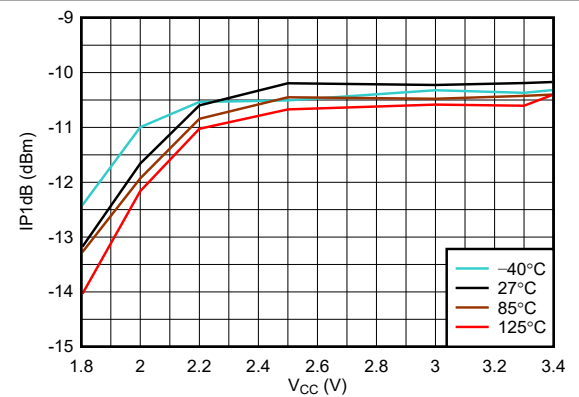
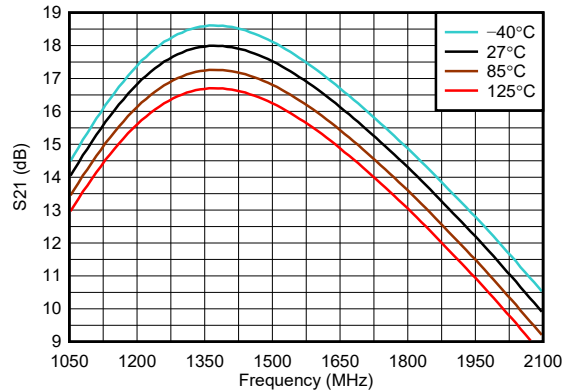


図 5-6. 温度範囲における $IP1\text{dB}$ と V_{CC} との関係

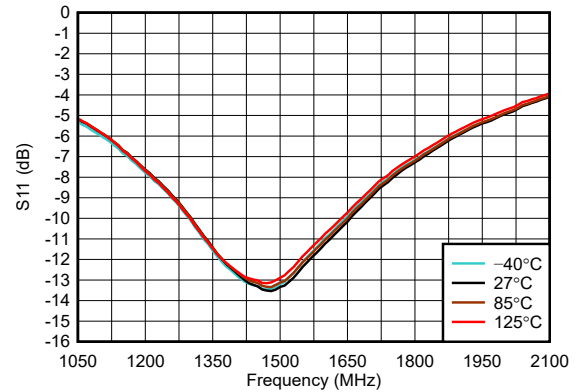
5.7 標準特性 – GPS L1 帯域 (続き)

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1575\text{MHz}$ (L1 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)



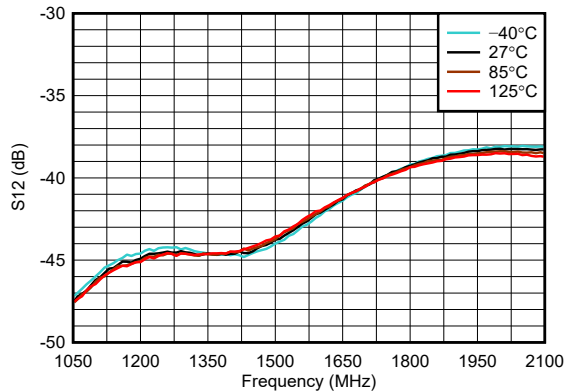
$V_{CC} = 1.8\text{V}$, $P_{IN} = -27\text{dBm}$

図 5-7. 動作温度範囲における電力ゲイン (S21)



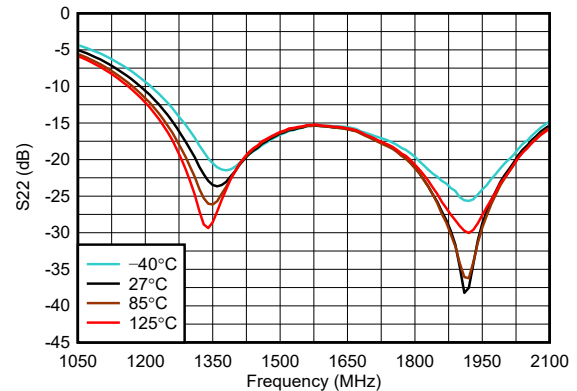
$V_{CC} = 1.8\text{V}$, $P_{IN} = -27\text{dBm}$

図 5-8. 温度範囲全体にわたる入力リターンロス (S11)



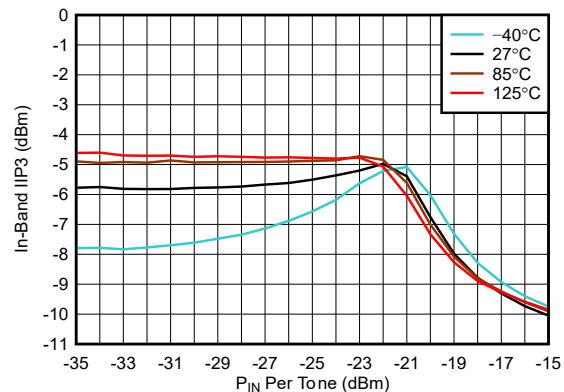
$V_{CC} = 1.8\text{V}$, $P_{IN} = -27\text{dBm}$

図 5-9. 温度範囲での逆絶縁 (S12)



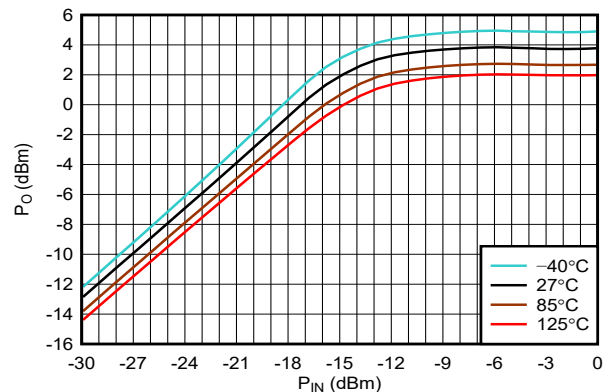
$V_{CC} = 1.8\text{V}$, $P_{IN} = -27\text{dBm}$

図 5-10. 温度範囲全体での出力リターンロス (S22)



$V_{CC} = 1.8\text{V}$, 5MHz のトーン間隔

図 5-11. 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (P_{IN}) との関係



$V_{CC} = 1.8\text{V}$

図 5-12. 温度範囲における出力電力 (P_O) と入力電力 (P_{IN}) との関係

5.7 標準特性 – GPS L1 帯域 (続き)

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1575\text{MHz}$ (L1 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

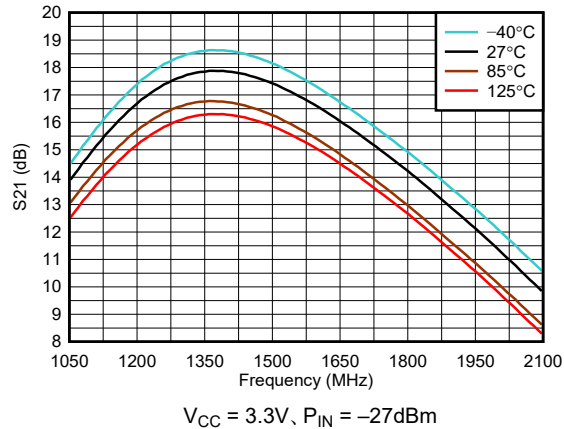


図 5-13. 動作温度範囲における電力ゲイン (S21)

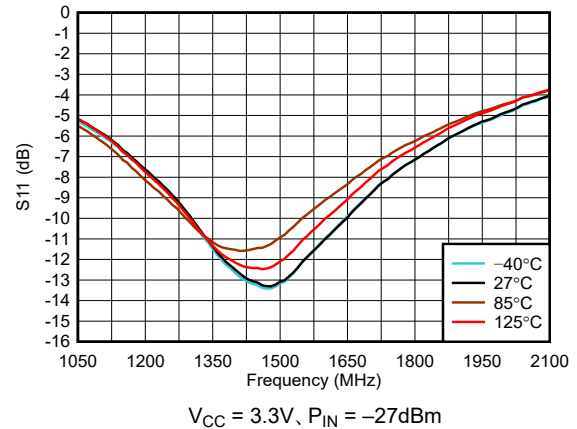


図 5-14. 温度範囲全体にわたる入力リターン ロス (S11)

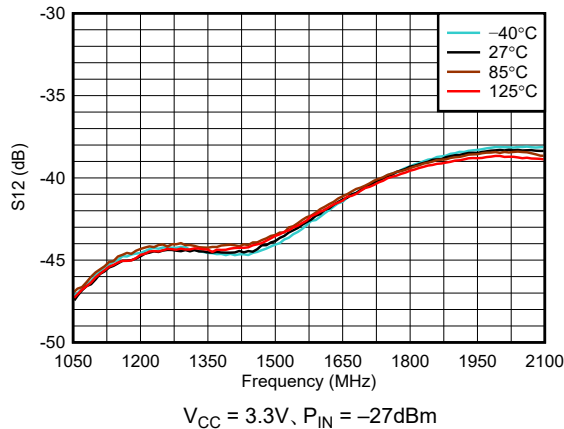


図 5-15. 温度範囲での逆絶縁 (S12)

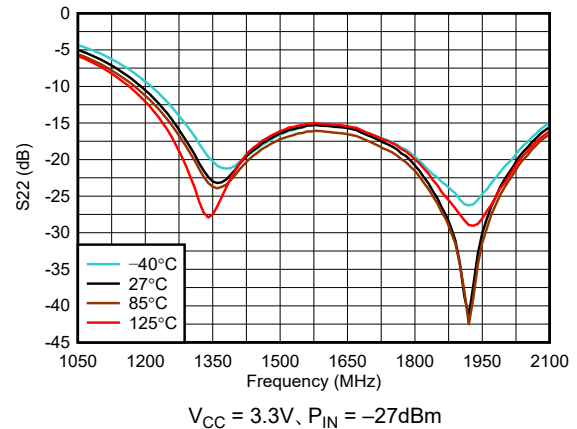


図 5-16. 温度範囲全体での出力リターン ロス (S22)

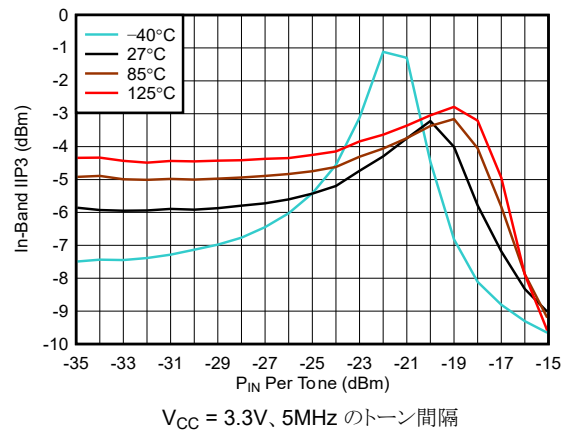


図 5-17. 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

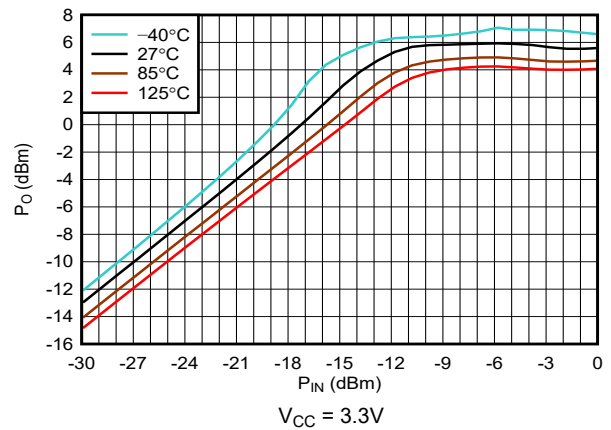


図 5-18. 温度範囲における出力電力 (P_O) と入力電力 (P_{IN}) との関係

5.7 標準特性 – GPS L1 帯域 (続き)

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1575\text{MHz}$ (L1 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

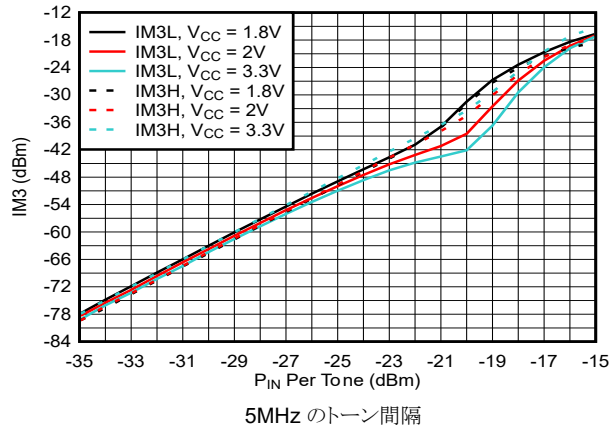


図 5-19. V_{CC} 範囲における帯域内 IM3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

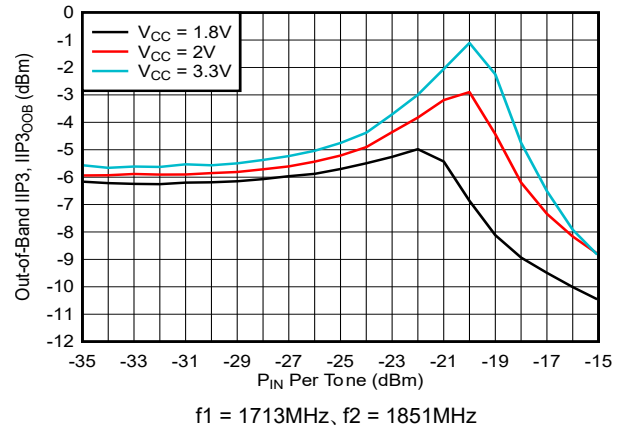


図 5-20. V_{CC} 範囲における帯域外 IIP3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

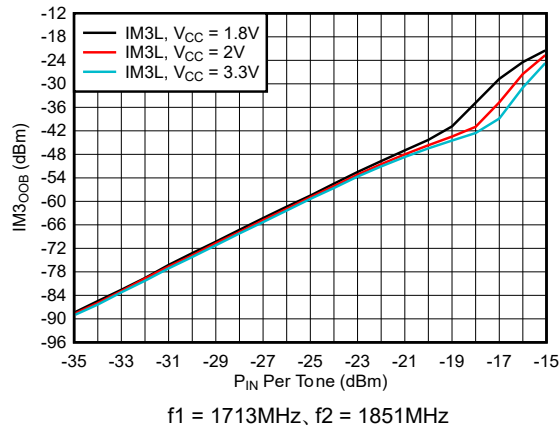


図 5-21. V_{CC} 範囲における帯域外 IM3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

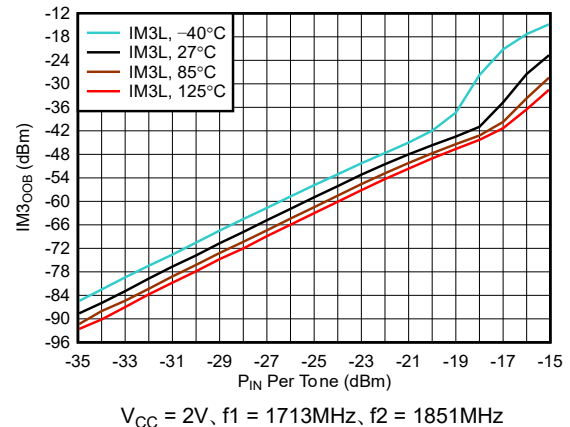


図 5-22. 温度範囲における帯域外 IM3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

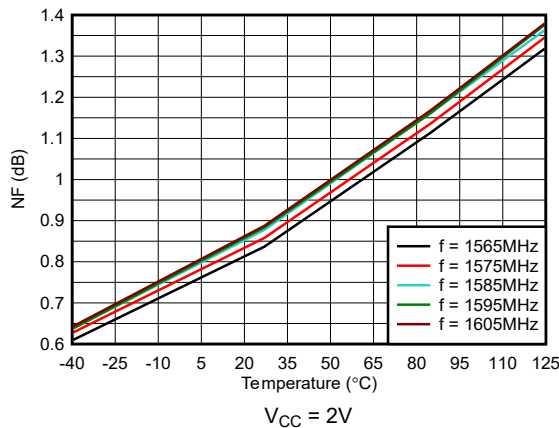


図 5-23. 周波数範囲における NF と温度との関係

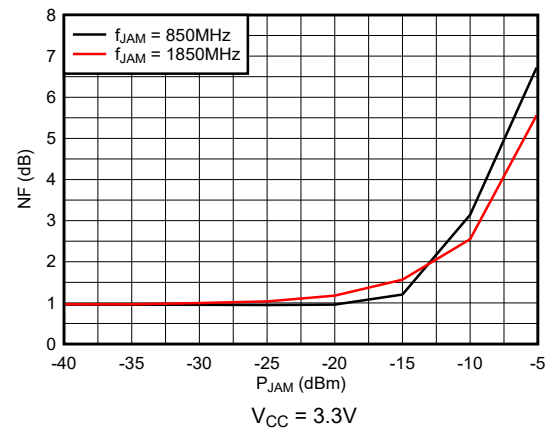


図 5-24. ジャマー周波数 (f_{JAM}) 範囲における NF とジャマー電力の関係 (P_{JAM}) との関係

5.7 標準特性 – GPS L1 帯域 (続き)

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1575\text{MHz}$ (L1 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 8.2\text{nH}$ (0402DC-8N2XGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

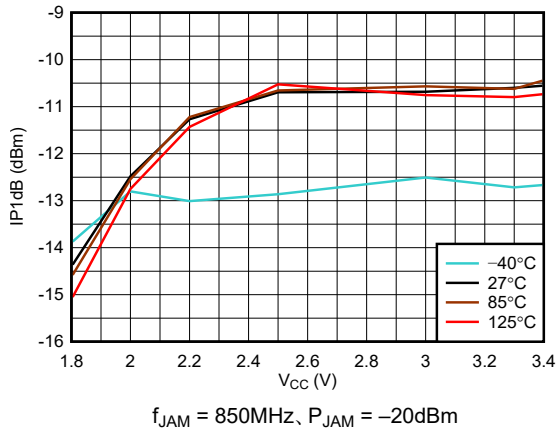


図 5-25. ジャマーでの全温度範囲における IP1dB と V_{CC} との関係

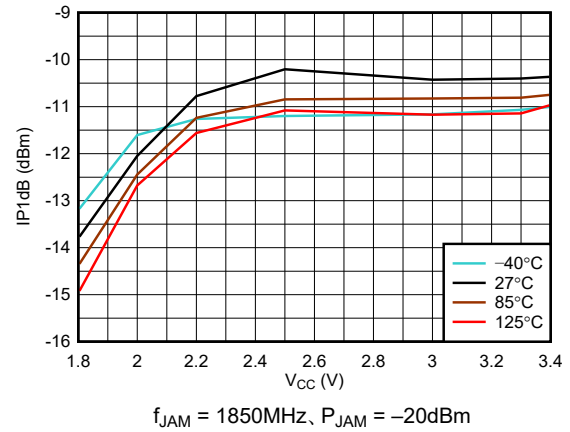


図 5-26. ジャマーでの全温度範囲における IP1dB と V_{CC} との関係

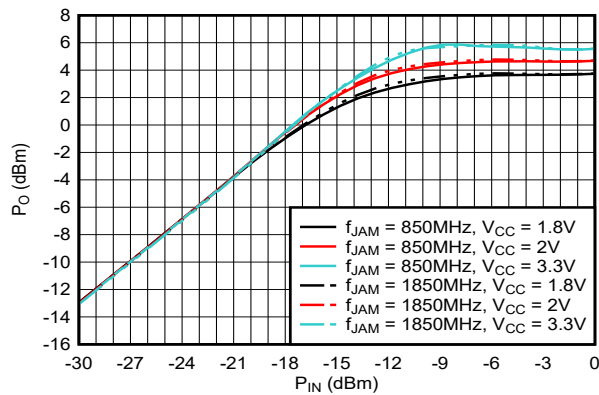


図 5-27. ジャマーと V_{CC} 範囲における出力電力 (P_O) と入力電力 (P_{IN}) との関係

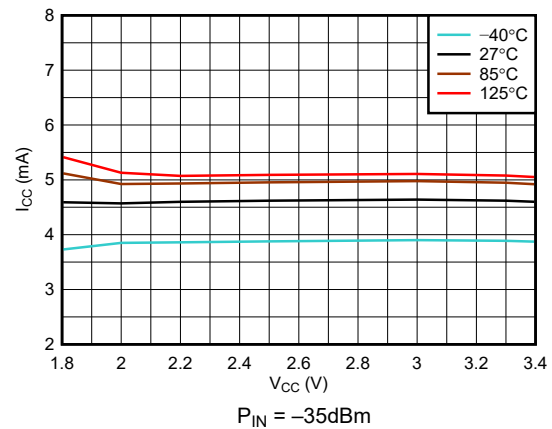


図 5-28. 温度範囲における I_{CC} と V_{CC} との関係

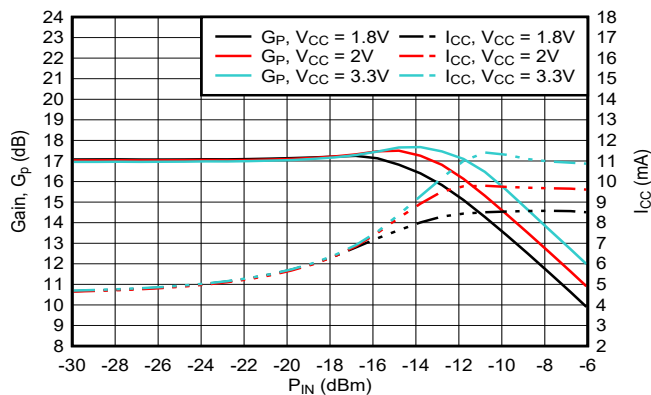


図 5-29. I_{CC} 範囲におけるゲインおよび V_{CC} と P_{IN} との関係

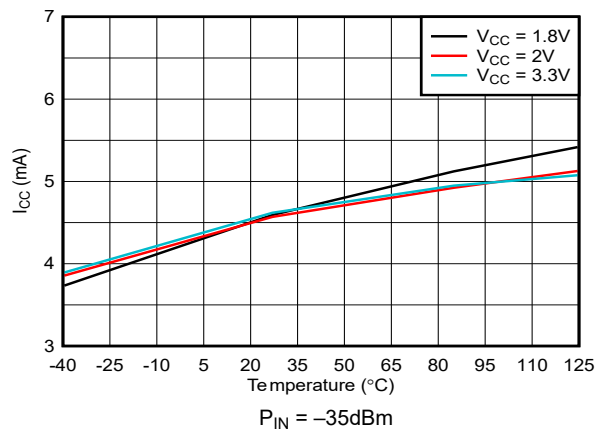


図 5-30. V_{CC} 範囲における I_{CC} と温度との関係

5.8 標準特性 - GPS L5 および L2 帯域

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1176\text{MHz}$ (L5 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

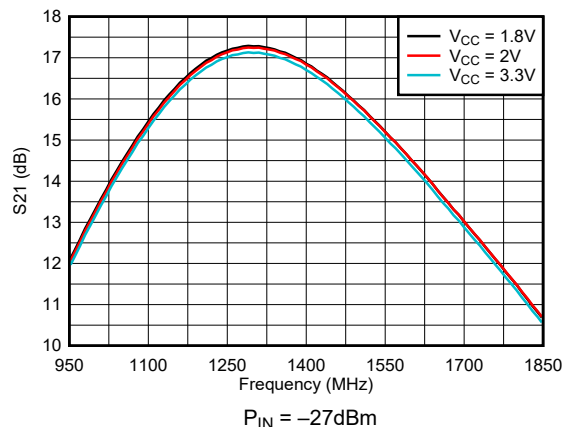


図 5-31. V_{CC} 範囲におけるパワーゲイン (S_{21})

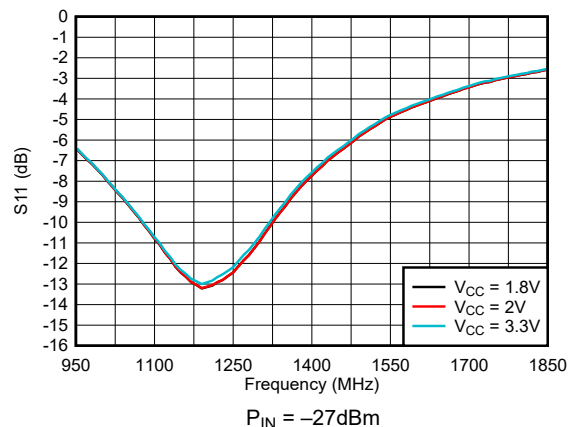


図 5-32. V_{CC} 範囲における入力反射損失 (S_{11})

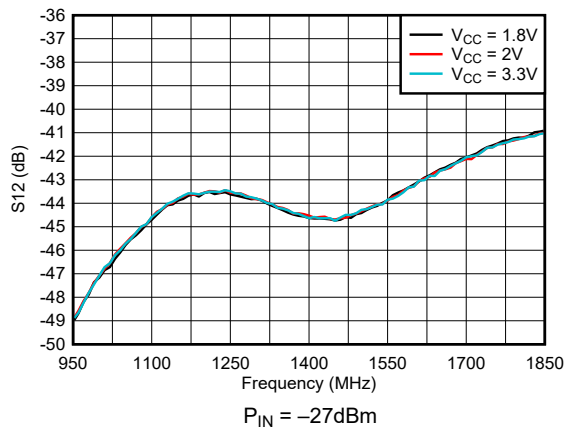


図 5-33. V_{CC} 範囲に置ける逆絶縁 (S_{12})

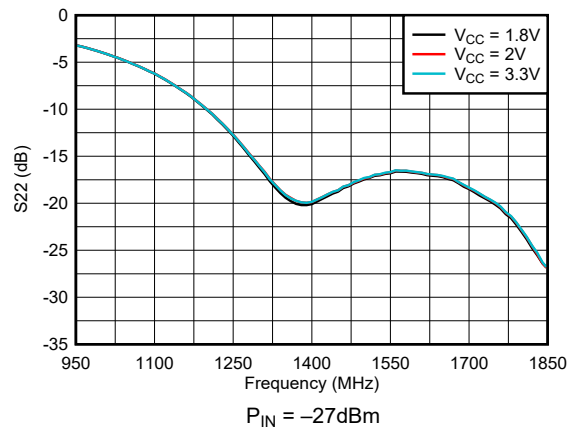


図 5-34. V_{CC} 範囲における出力反射損失 (S_{22})

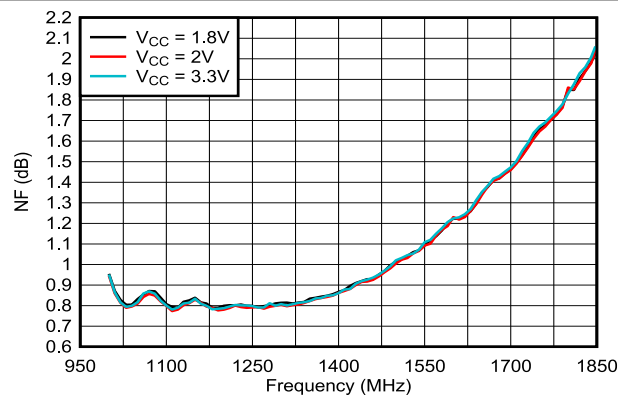


図 5-35. V_{CC} 全体での NF

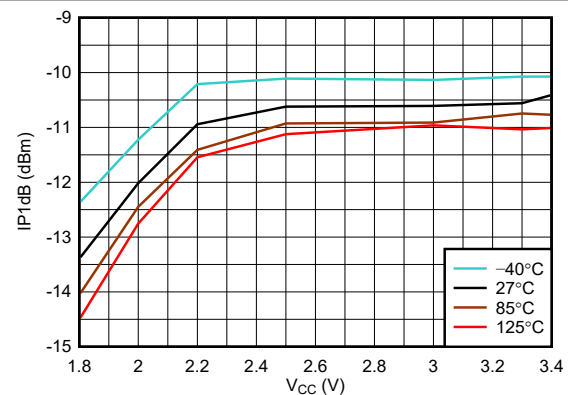


図 5-36. 温度範囲における $IP1\text{dB}$ と V_{CC} との関係

5.8 標準特性 - GPS L5 および L2 帯域 (続き)

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1176\text{MHz}$ (L5 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

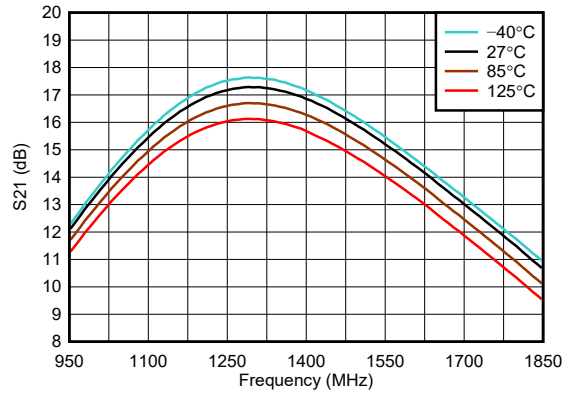


図 5-37. 動作温度範囲における電力ゲイン (S21)

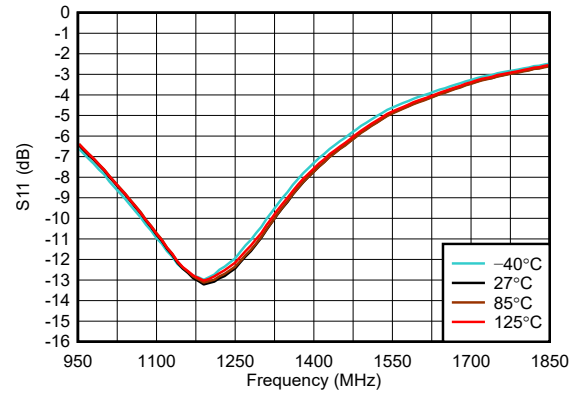


図 5-38. 温度範囲全体にわたる入力リターン ロス (S11)

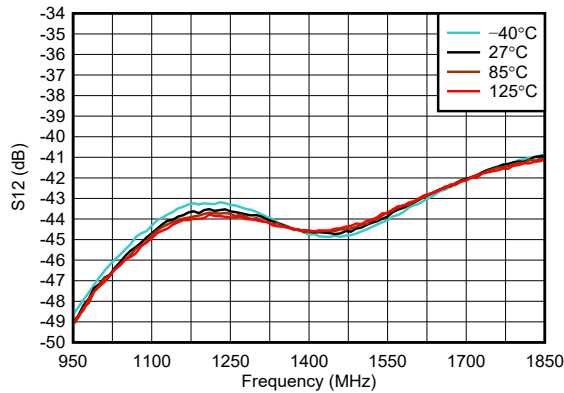


図 5-39. 温度範囲での逆絶縁 (S12)

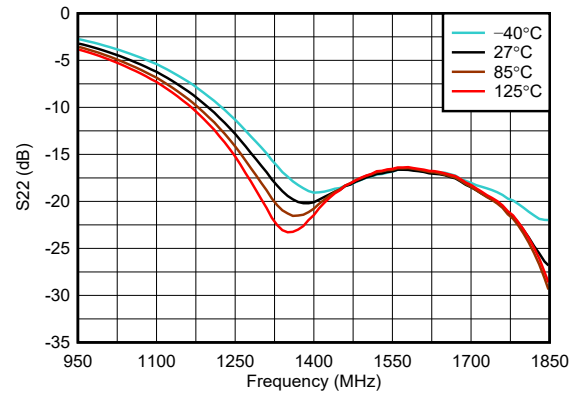


図 5-40. 温度範囲全体での出力リターン ロス (S22)

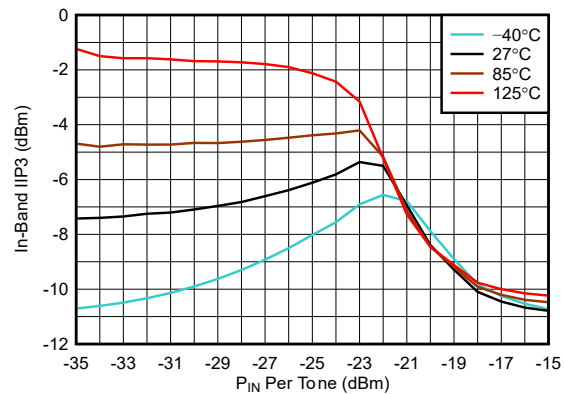


図 5-41. 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

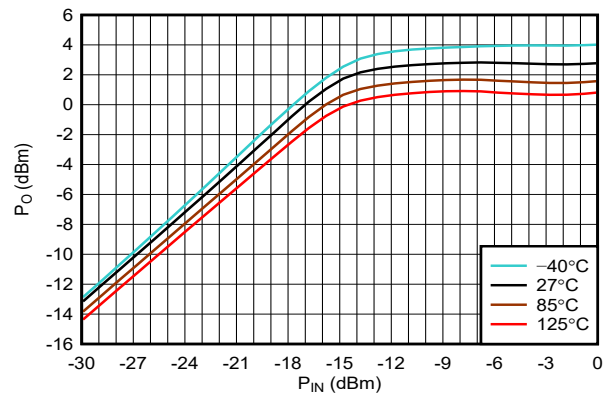


図 5-42. 温度範囲における出力電力 (P_O) と入力電力 (P_{IN}) との関係

5.8 標準特性 - GPS L5 および L2 帯域 (続き)

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1176\text{MHz}$ (L5 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

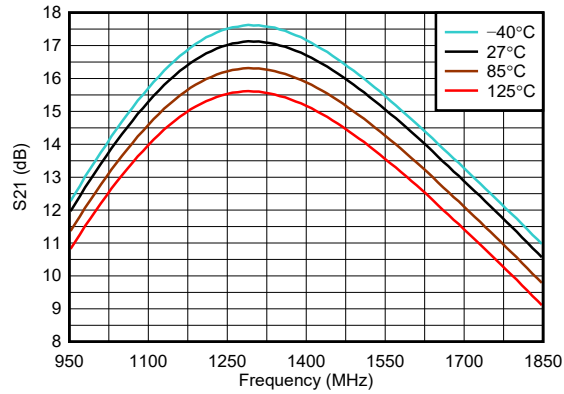


図 5-43. 動作温度範囲における電力ゲイン (S_{21})

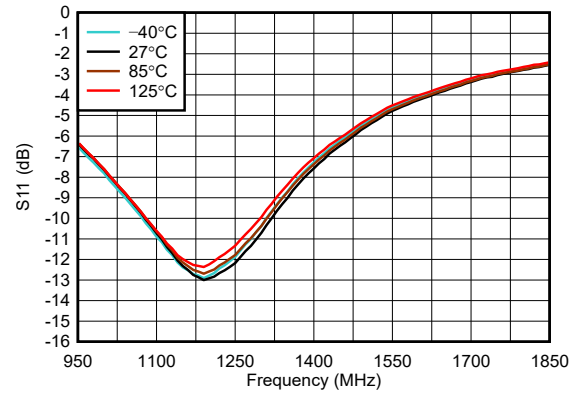


図 5-44. 温度範囲全体にわたる入力リターン ロス (S_{11})

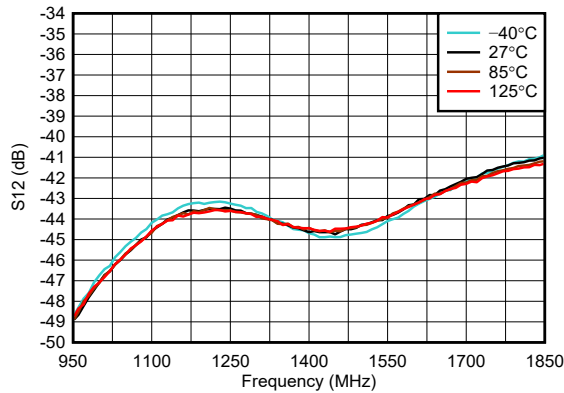


図 5-45. 温度範囲での逆絶縁 (S_{12})

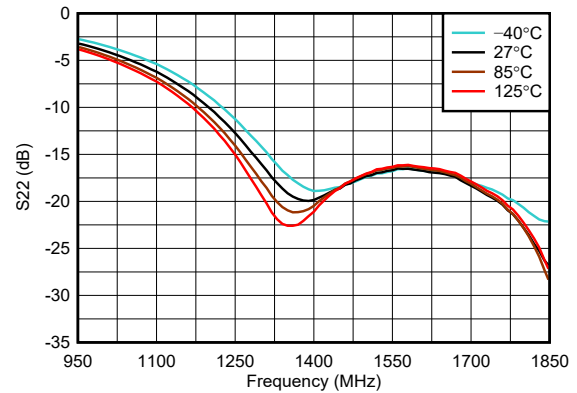


図 5-46. 温度範囲全体での出力リターン ロス (S_{22})

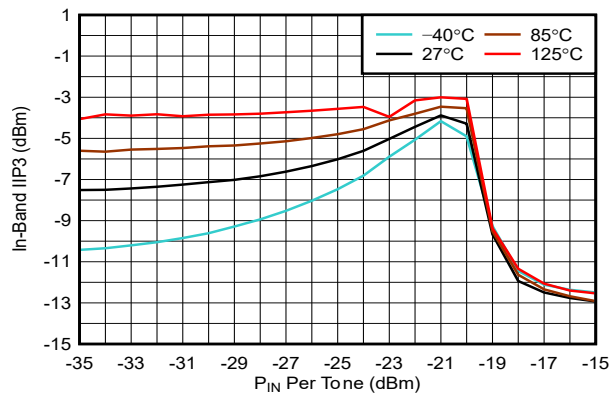


図 5-47. 温度範囲における帯域内 IIP3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

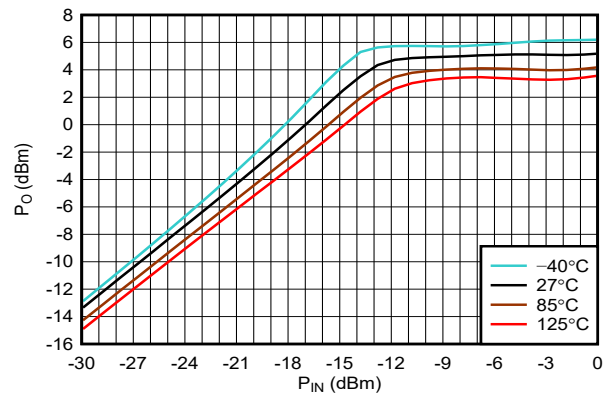


図 5-48. 温度範囲における出力電力 (P_O) と入力電力 (P_{IN}) との関係

5.8 標準特性 - GPS L5 および L2 帯域 (続き)

$T_A = 27^\circ\text{C}$ で、 $V_{CC} = 2.5\text{V}$ 、 $f = 1176\text{MHz}$ (L5 帯域)、ソースインピーダンス (Z_S) = 負荷インピーダンス (Z_L) = 50Ω 、図 6-2 に示す入力および出力構成で $L1 = 11\text{nH}$ (0402DC-11NXGRW) および $C1 = 10\text{pF}$ (GJM1555C1H100JB01) の入力が 50Ω と一致、入力のコンデンサ $C1$ と出力の RFOUT および表示の周囲温度次第で組み込み解除 (特に記述のない限り)

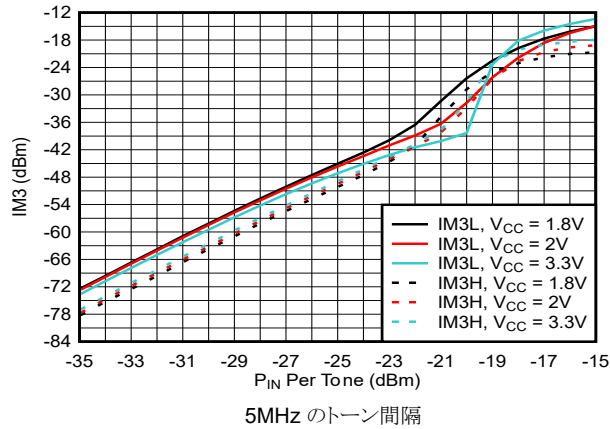


図 5-49. V_{CC} 範囲における帯域内 IM3 と入力電力 (P_{IN}) との関係

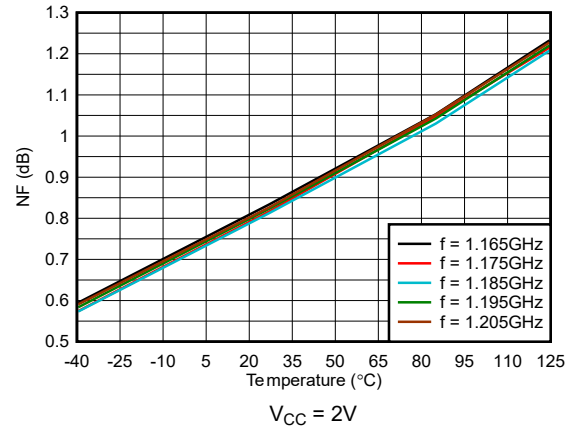


図 5-50. 周波数範囲における NF と温度との関係

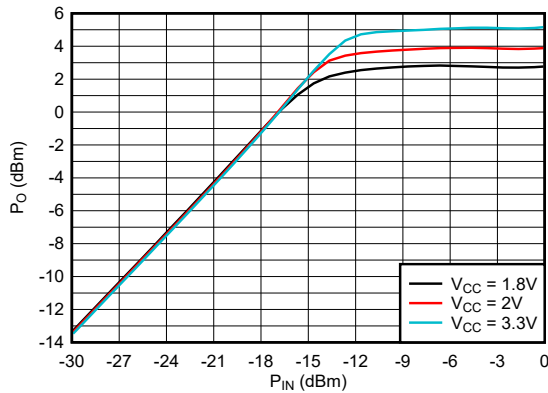


図 5-51. V_{CC} 範囲における出力電力 (P_O) と入力電力 (P_{IN}) との関係

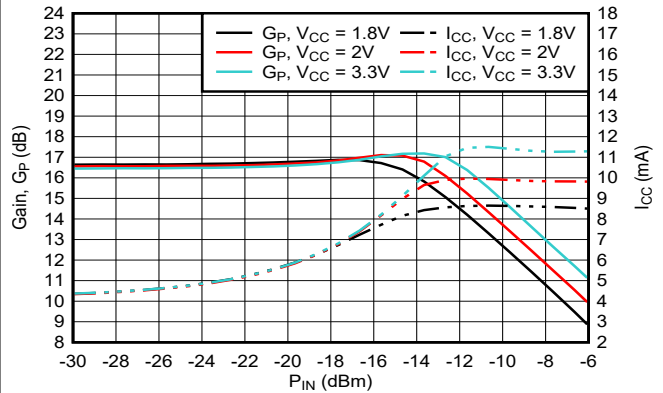


図 5-52. I_{CC} 範囲におけるゲインおよび V_{CC} と P_{IN} との関係

6 詳細説明

6.1 概要

TRF3302 は、GNSS/GPS レシーバの GNSS 信号感度を向上させるように設計された GNSS/GPS LNA で、全地球測位装置、ナビゲーション、タイミングサービスを提供する広範な衛星配線をサポートしています。このデバイスには、デバイスを省電力シャットダウンモードに移行させるために使用するイネーブルピン (EN) があります。この機能により、外部電源切断スイッチが不要になり、 V_{CC} 電源全体を停止する必要はありません。

このデバイスは、1.8V ~ 3.3V の単一電源で動作し、標準的な消費電流 4.6mA で、-10.2dBm IP1dB を実現します。このデバイスは、ウェットタブフランク付きの 1.3mm × 1mm、6 ピン、WSON-FCRLF パッケージで供給されます。

6.2 機能ブロック図

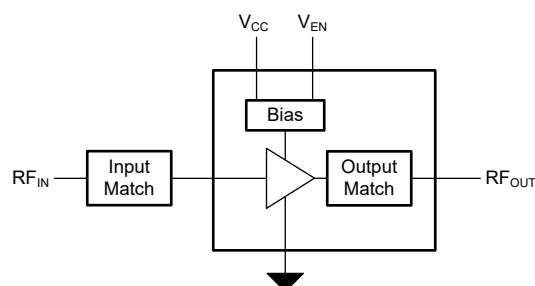


図 6-1. TRF3302 機能ブロック図

6.3 機能説明

TRF3302 は汎用 LNA であり、上側または下側いずれかの L 帯域周波数でシングル GNSS 帯域マッチングの性能を最適化するように構成、または 1165MHz から 1630MHz の複数の GNSS 帯域内の広範な周波数に対応するように構成できます。

TRF3302 は広帯域出力一致を内蔵しており、GNSS レシーバと通信するための外部マッチング部品が不要で、BOM 点数とソリューションサイズを削減できます。要求されるオフチップ入力を一致させると、システム固有の要件に合わせてデバイス性能を最適化する柔軟性が得られます。シングル GNSS 帯域で動作する場合は、2 要素一致 (図 6-2 を参照) で十分です。4 素子を一致 (図 6-3 を参照) させると、広範なマルチバンドマッチングにより、NF、ゲイン、S11 の性能を最適化できます。

6 ピン WSON-FCRLF パッケージは、自動光学検査 (AOI) による半田付け部の目視検査が可能なウェットプルフランクを採用しており、高価な X 線検査システムの製造コストなしで製品の信頼性を向上させることができます。TRF3302 のピン配置 (図 4-1 を参照) は、RFIN ピンの周囲に RF グラウンドピン (VCC と GND) を配置し、RFOUT ピンの周囲に EN と GND を配置して、PCB レイアウトと RF 性能のために最適化されています。

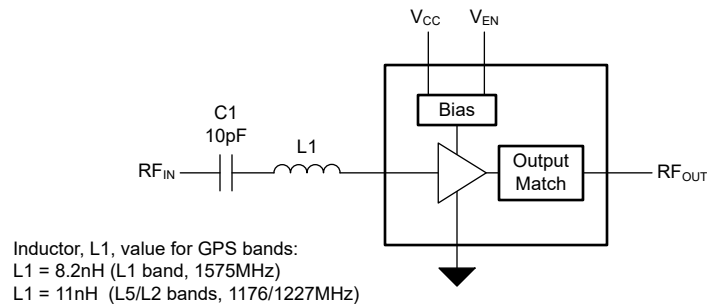


図 6-2. TRF3302 の代表的なシングル GNSS 帯域構成

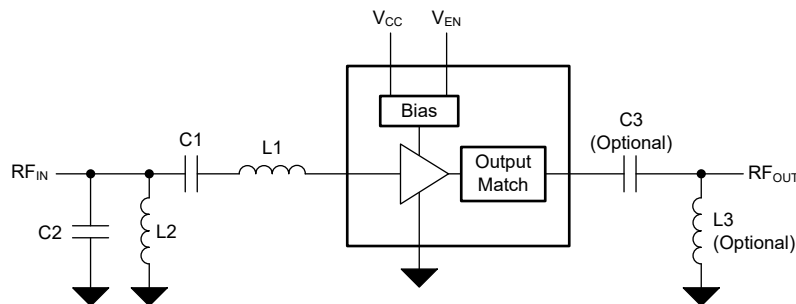


図 6-3. TRF3302 の代表的なマルチ GNSS 帯域構成

6.4 デバイスの機能モード

TRF3302 には EN ピンがあり、デバイスを有効にするためにこのピンを強制的に High (ロジック 1) にする必要があります。デバイスの電源をオフにするには、EN ピンをグラウンド電位 (ロジック 0) に接続します。デバイスを適切に動作させるには、EN ピンをフローティングにすることはできず、電圧を強制的に印加する必要があります。

7 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 アプリケーション情報

TRF3302 は、シングルエンドの入力および出力 LNA です。このデバイスは通常、GNSS レシーバの感度を向上させる GNSS 全地球測位システムで使用されます。この向上は、デバイスの 0.8dB NF を、上位または下位の L 帯域 GNSS システムの約 17dB のゲインと組み合わせることにより実現しています。受信アンテナが GNSS レシーバから離れており、ケーブルまたは長いパターンで接続されているシステムでは、TRF3302 を使用すると、信号が GNSS レシーバに達する前に信号が増幅され、アンプのノイズが最小限に抑えられるため、ノイズビックアップに対する信号耐性の向上に役立ちます。上側と下側の L 帯域を同時にサポートする必要があるシステムでは、広帯域入力マッチング回路を TRF3302 と共に使用します (セクション 7.2.1 を参照)。

7.2 代表的なアプリケーション

7.2.1 マルチバンド構成の TRF3302

図 7-1 に、マルチバンド構成の TRF3302 の代表的なアプリケーションを示します。これらは AFE を駆動する上側と下側の GNSS L 帯域を同時にカバーします。

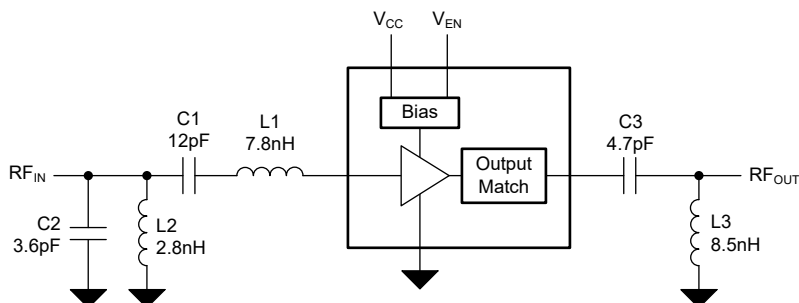


図 7-1. L1、L2、L5 の GPS 帯域をカバーする構成の TRF3302

7.2.1.1 設計要件

マルチバンド受信アプリケーションの主な設計要件は、目的の周波数範囲に合わせて NF、ゲイン、S11 を最適化することです。主要な上側と下側の GNSS L 帯域をすべてカバーする 1165MHz から約 1630MHz までの周波数範囲をサポートする、図 6-3 の入力マッチング回路を選択します。TRF3302 の S22 は本質的に広帯域で、1200MHz から 1630MHz を超える範囲で -10dB 未満です。対象となる周波数範囲全体で、1165MHz から 1630MHz までの出力反射損失 (S22) が -10dB 未満となるように、オプションの出力一致を選択してください。

7.2.1.2 詳細な設計手順

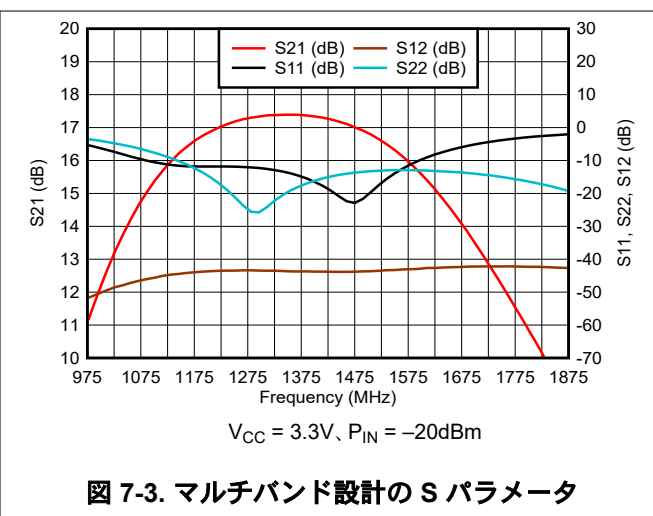
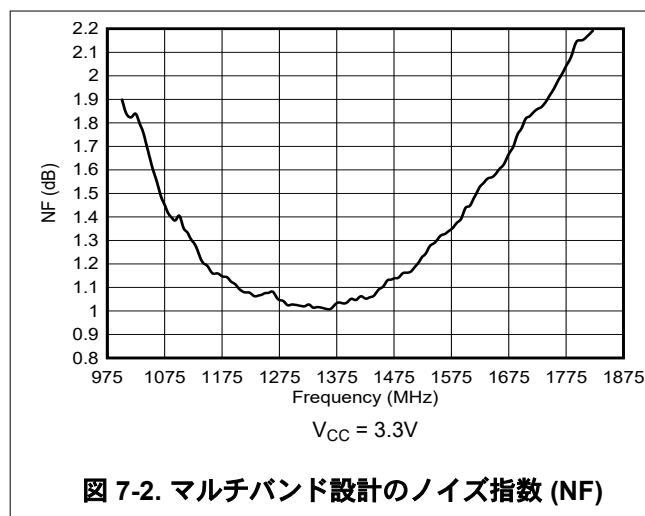
表 7-1 に、設計要件に合わせて選択したマッチング回路部品を示します。TRF3302 の S パラメータは、ゲイン、S11、S22 の各応答に最適化された部品の値を取得するために使用され、TRF3302 評価基板を使用してベンチで検証されています。

表 7-1. 回路部品の値のマッチング

部品	部品の値	部品番号
インダクタ、L1	7.8nH	0402DC-7N8
コンデンサ、C1	12pF	GJM1555C1H120JB01
インダクタ、L2	2.8nH	0402DC-2N8
コンデンサ、C2	3.6pF	GJM1555C1H3R6BB01
インダクタ、L3	8.5nH	0402DC-8N5
コンデンサ、C3	4.7pF	GJM1555C1H4R7BB01

7.2.1.3 アプリケーション曲線

図 7-2 と 図 7-3 は、それぞれマルチバンド設計の NF と S パラメータの応答を示しています。



7.3 電源に関する推奨事項

TRF3302 は、単一の 1.8V ~ 3.3V 電源電圧で動作します。デバイス近くに配置したデカップリングコンデンサによって電源電圧を絶縁します。自己共振周波数がアプリケーション周波数より高いコンデンサを選択してください。複数のコンデンサを並列で使用して広帯域デカップリング回路を構築する場合は、自己共振周波数が高いコンデンサをデバイスの近くに配置します。

7.4 レイアウト

7.4.1 レイアウトのガイドライン

図 7-4 に、TRF3302 の優れたレイアウト例が示されています。最上部の信号レイヤのみを示しています。ゲインの大きい比較的広帯域の RF LNA を設計する場合は、安定性と最適化された性能を維持するために、基板レイアウトに関する特定の注意事項を考慮してください。マルチレイヤ基板を使用して、信号インテグリティとパワーインテグリティを維持します。

- すべての入出および出力のマッチング部品、特に高 Q 入力のマッチングインダクタは、RF ピンにできるだけ近づけて配置してください。
- RF 入力および出力信号を接地された同一平面導波管 (GCPW) パターンとして配線します。
- 最上レイヤと任意の内部レイヤのグランドプレーンがビアと十分にステッチされていることを確認します。PCB の 2 番目のレイヤには、LNA 付近のカットアウトがなく連続的なグランドレイヤがあります。
- クロックやデジタル制御ラインは RF 信号ラインの近くに配線しないでください。
- RF または DC 信号ラインはノイズの多いパワープレーンの上に配線しないでください。
- デバイスの近くに電源デカップリングコンデンサを配置してください。

基板レイアウトと設計の詳細については、『[TRF3302 評価基板ユーザーガイド](#)』を参照してください。

7.4.2 レイアウト例

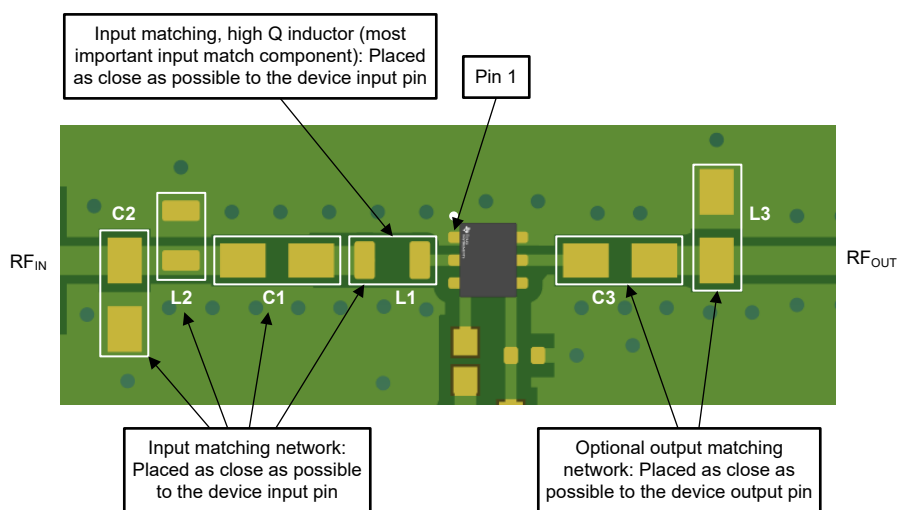


図 7-4. レイアウト例

8 デバイスおよびドキュメントのサポート

8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
October 2025	*	草稿のみ

10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TRF3302VBLR	Active	Production	WSO-FCRLF (VBL) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	P30

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TRF3302 :

- Automotive : [TRF3302-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects



WSN-FCRLF - 0.7 mm max height

Technical drawing of a connector housing, showing dimensions and features:

- Top View:**
 - Overall width: 1.1 (nominal), 0.9 (minimum)
 - Overall height: 1.4 (nominal), 1.2 (minimum)
 - PIN 1 INDEX AREA:** Indicated by a hatched pattern in the top-left corner.
- Side View:**
 - Overall height: 0.7 (nominal), 0.6 (minimum)
 - SEATING PLANE:** Indicated by a dashed line and a triangle symbol.
 - SECTION A-A TYPICAL:** A cross-sectional view showing the internal structure and dimensions:
 - Top thickness: 0.01 (nominal), 0.00 (minimum)
 - Internal width: (0.1)
 - Bottom thickness: 0.1 MIN
- Front View (Left):**
 - SYMM** (Symmetry) symbol.
 - Pin 1 ID (45° X 0.1) is indicated.
 - Dimensions: 6X (0.13), 3, 2X (0.8), 4X (0.4), 1, 6X (0.5), 0.3.
- Front View (Right):**
 - Dimensions: 0.01 (nominal), 0.00 (minimum), (0.2) TYP.
- Feature Callouts:**
 - 0.08 C:** Chamfer feature.
 - 0.1 M, 0.05 M:** Hole features.
 - C, A, B:** Positioning features.

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.

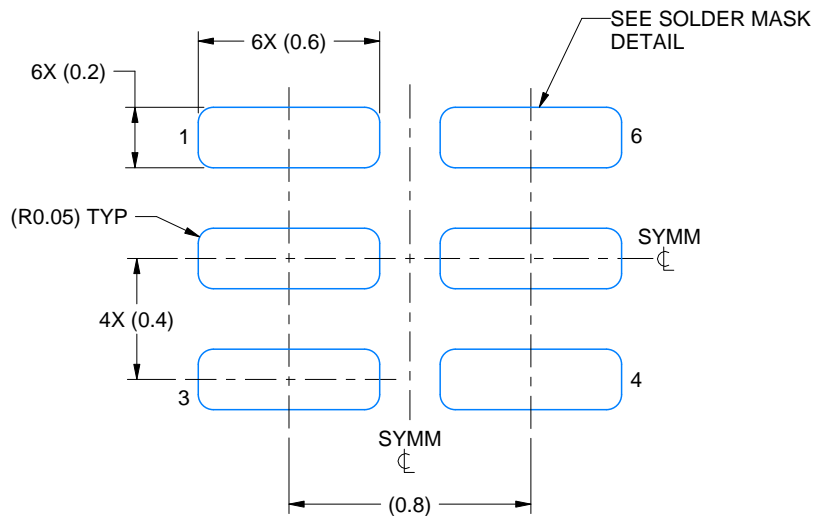
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

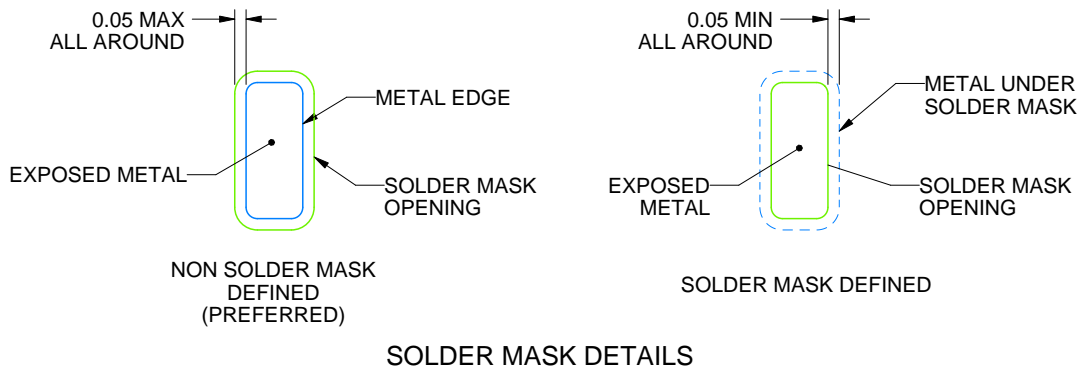
VBL0006A

WSN-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 40X



4230092/B 01/2025

NOTES: (continued)

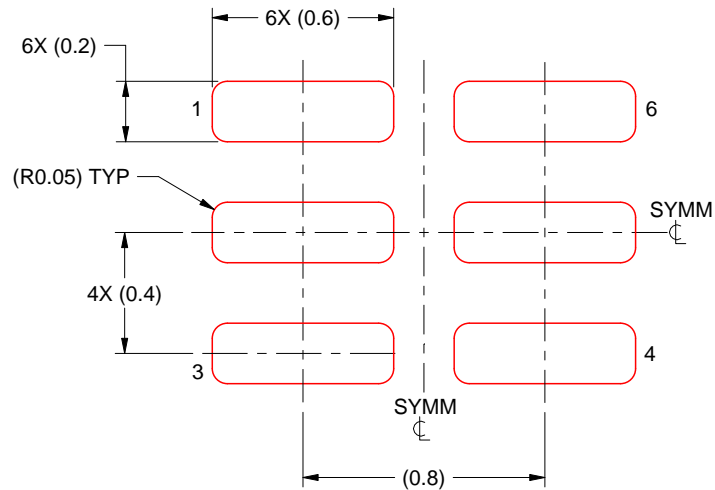
3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slue271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

VBL0006A

WSO-FCRLF - 0.7 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 MM THICK STENCIL
SCALE: 40X

4230092/B 01/2025

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月